DI Corporation

Investor Relations

May 2026

Disclaimer

본 자료에 포함된 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는 한국 기업회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다.

이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무 실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

또한 향후 전망은 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로서 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 입증자료로써 사용될 수 없습니다.

Contents

I Corporate Overview

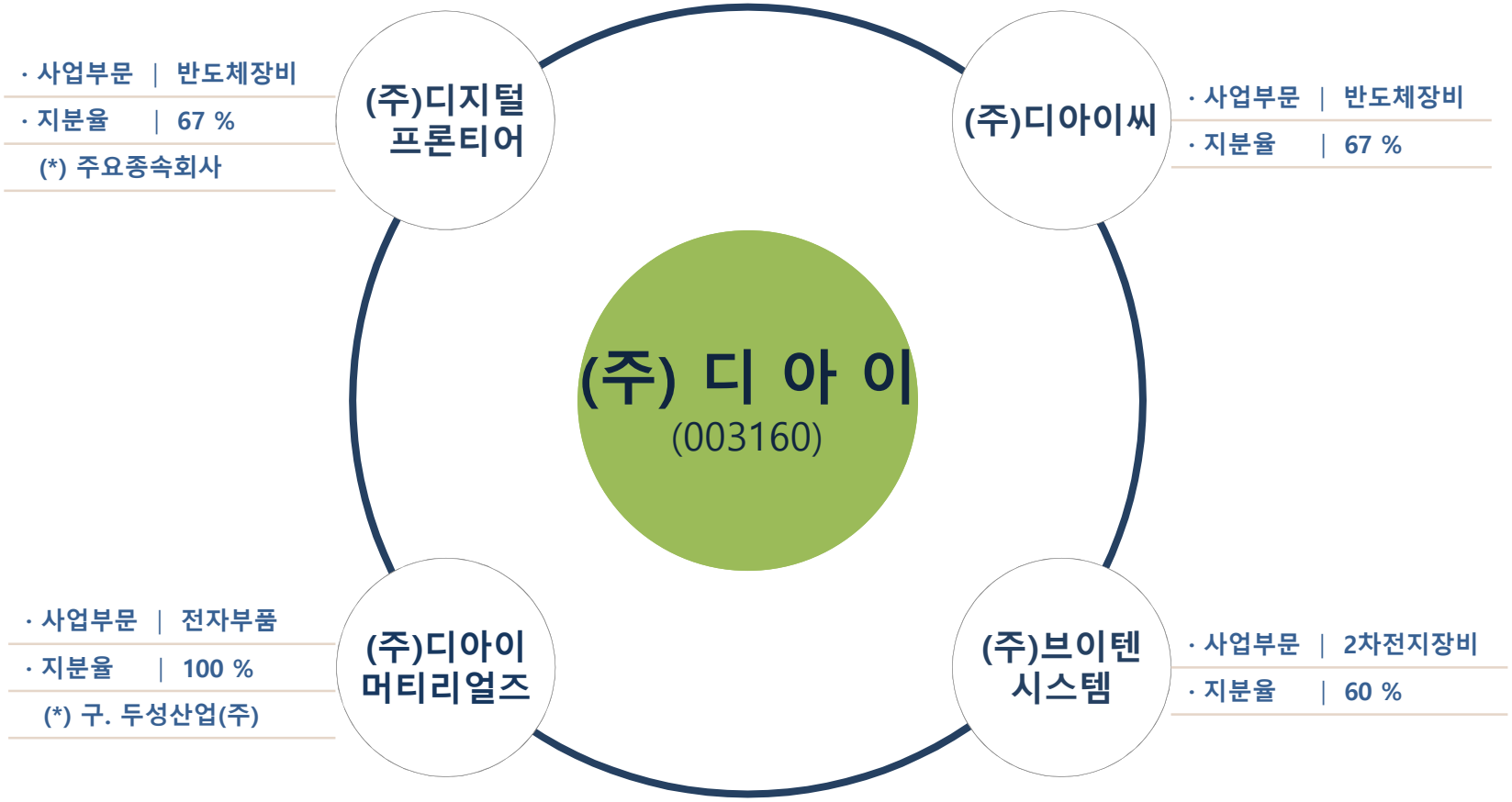
II Business Area

III Business Performance

I Corporate Overview

1. 지 배 구 조
2. 회 사 개 요
3. 회 사 연 혁
4. 주 주 환 원

I 1. 지 배 구 조


· 사업부문 | 반도체장비
· 지분율 | 67 %
(*) 주요종속회사
(주)디지털 프론티어
(주)디아이씨
· 사업부문 | 반도체장비
· 지분율 | 67 %
(주) 디 아 이
(003160)
· 사업부문 | 전자부품
· 지분율 | 100 %
(*) 구. 두성산업(주)
(주)디아이 머티리얼즈
(주)브이텐 시스템
· 사업부문 | 2차전지장비
· 지분율 | 60 %

(주) 디 아 이

대표이사	박 원 호 회 장 조 윤 형 부 사 장
설 립 일	1961년 3월 16일 (1996년 7월 31일 상장)
임직원수	179명 ('26. 3월말 기준)
주요사업	반도체 검사장비 및 부품 제조업
자 본 금	17,248,392,500 원
발행주식수	28,300,000 주
소 재 지	본사 : 서울시 강남구 논현로 703 디아이B/D 공장 : 경기도 화성시 삼성1로 3길 32 (동탄사업장)
홈페이지	www.di.co.kr

(주) 디지털프론티어 (*)

대표이사	오 성 구 사 장
설 립 일	2007년 1월 31일
임직원수	96명 ('26. 3월말 기준)
주요사업	반도체 검사장비 및 부품 제조업
자 본 금	2,128,000,000 원
발행주식수	21,280,000 주
소 재 지	본사/공장 : 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 281 ('26. 1월 본점 이전)
홈페이지	www.dfinc.co.kr

(*) 주요종속회사

(주) 디 아 이

2021.01	차세대 Burn-In Tester 양산기 납품 개시
2017.08	Burn-In Tester 2,000대 출하 달성
2014.02	Logic Burn-In Tester 양산기 납품
2013.05	Multi Flexibility Tester 양산기 납품
2010.12	Burn-In Tester 400호기 수출성과 달성
2007.11	제44회 무역의 날 5,000만불 수출탑 수상
2007.08	D.I China 설립 (소주 사무소)
2006.06	Burn-In Tester 세계 일류상품 선정
2006.02	'전자수출 1,000억 달러 달성' 기념 산업자원부 장관 공로패 수상
2005.11	제42회 무역의 날 2,000만불 수출탑 수상
2005.10	D.I Taiwan 설립 (신주 지사)
2005.09	제1회 대한민국반도체기술대상 최첨단기술상(국무총리상) 수상
2003.02	D.I Japan 설립 (동경 현지법인)
1996.07	기업공개 (거래소 상장)
1996.04	주식회사 디아이로 사명변경
1955.06	동일교역 설립

(주) 디지털프론티어 (*)

2026.03	HBM4 웨이퍼 테스터 (DF-5100) 양산기 납품 개시
2026.01	경기도 수원시 권선구 산업로155번길 281로 본점.공장 이전
2025.01	HBM 웨이퍼 테스터 (DF-5200) 확대 적용
2024.03	DRAM 웨이퍼 테스터 (DF-5200) 양산기 납품 개시
2021.01	경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9로 본점 이전
2019.04	SK하이닉스 기술혁신기업 선정
2018.04	ISO9001 품질경영시스템, ISO14001 환경경영시스템 인증
2017.09	NAND 웨이퍼 테스터 (DF-8600) 양산기 납품 개시
2017.08	NAND 패키지 번인테스터 (DF-2200) 양산기 납품 개시
2014.03	경기도 성실납세자 선정
2012.05	㈜디아이로 최대주주 변경
2008.08	반도체 검사장치 특허등록 (특허 제10-0856079호)
2008.03	기업부설연구소 설립 인가 (한국산업기술진흥협회)
2007.05	PTBI FOS-8400 발주서 수령 (구매 금액 : 49억원)
2007.04	PTBI FOS-8400 개발 장비 납품 완료
2007.01	㈜디지털프론티어 설립

(*) 주요종속회사

‘주주가치 제고 · 장기투자 유치 노력 지속’

· ‘22년말 자기주식 320만주(10%) 대규모 소각

· 최근 12년 연속 현금배당 실시, 12년 누계 배당성향 42%

※ 과거 배당이력

사업연도	주당 배당금	액면 배당률	시가 배당률	배당성향
2025년	250원	50%	1.2%	127.6%
2024년	100원	20%	0.8%	237.5%
2023년	100원	20%	1.6%	82.1%
2022년	100원	20%	2.0%	17.7%
2021년	200원	40%	2.2%	33.7%
2020년	100원	20%	2.3%	47.4%
2019년	50원	10%	1.6%	256.5%
2018년	50원	10%	1.4%	13.9%
2017년	100원	20%	2.0%	16.6%
2016년	50원	10%	1.1%	392.9%
2015년	50원	10%	0.7%	101.3%
2014년	75원	15%	1.1%	71.6%

연속배당 횟수		평균 배당수익률		
분기(중간)배당	결산배당	최근3년	최근5년	최근10년
-	12회	1.2%	1.6%	1.6%

※ 자기주식 소각

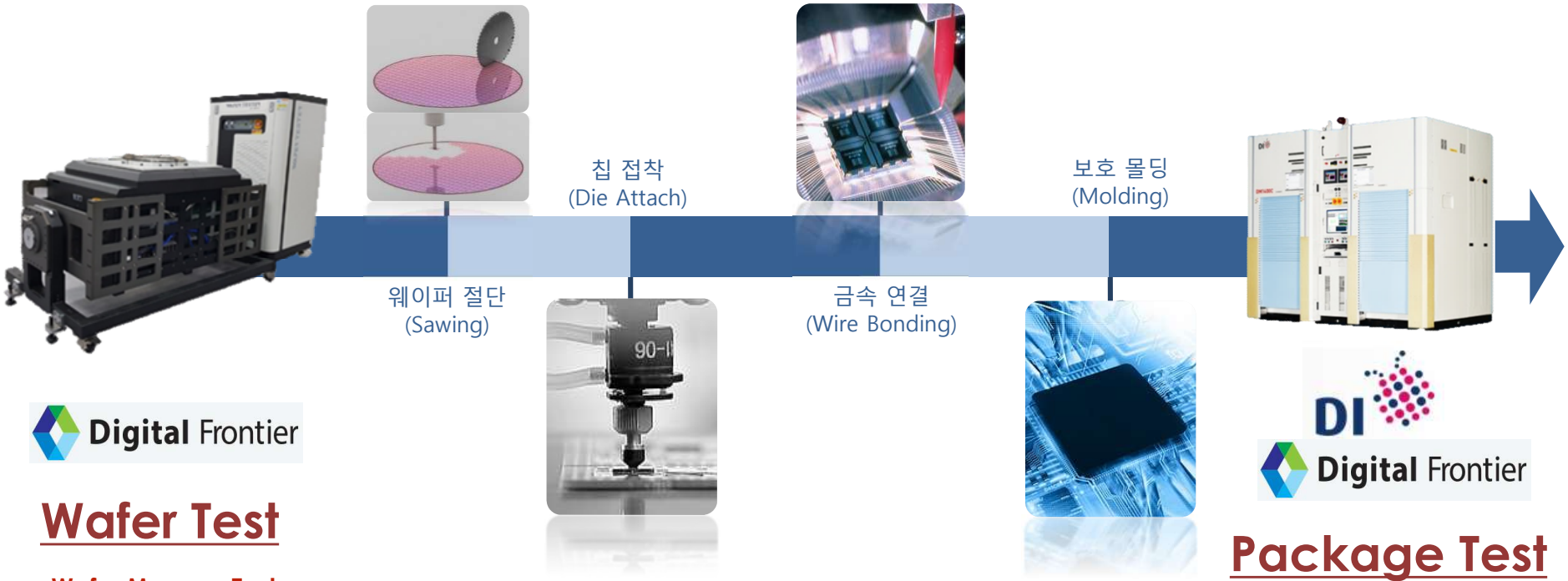
구 분	내 용
① 소각전 발행주식총수	31,496,785 주
② 소각주식수	3,196,785 주
③ 소각주식비중	10.15 %
④ 소각금액(시가)	17,198,703,300 원
⑤ 소각금액(장부)	9,151,164,364 원
⑥ 소각일	2022-12-14
⑦ 소각구분	자본금 감소 없는 이익 소각
⑧ 소각목적	주주 환원 및 주주가치 제고
⑨ 소각후 발행주식총수	28,300,000 주

II Business Area

1. 사 업 분 야
2. 제 품 현 황
3. 고 객 사

INSIGHT DI

반도체 후공정 (Back-End)



Digital Frontier

Wafer Test

- Wafer Memory Tester
- Wafer Level Burn-In Tester

DI Digital Frontier

Package Test

- Monitoring Burn-In Tester
- Test Burn-In Tester
- Multi Flexible Tester
- Memory Burn-In Board
- Logic Burn-In Board

메모리 웨이퍼 검사장비



· Wafer 단계 성능/신뢰성 Test를 통한 수율 개선
- Device: HBM, DRAM, NAND Flash 外

· SKH – '18 NAND Wafer Tester 공급
'24 DRAM Wafer Tester 공급
'25 HBM3/3E Wafer Tester*(B/I, Core)* 공급
'26 HBM4 Wafer Tester*(B/I, Core)* 공급 개시

· 기존 일본 A社 장비 독점 영역 침투,
고객사 내 점유율 점진적 확대 中

· HBM4 Wafer Tester*(B/I, Core)* '25.10 품질평가 완료

메모리 패키지 검사장비



Monitoring Burn-In Tester



Multi Flexible Tester
(High Speed)

- Package 공정 후 Cell 단위 신뢰성 Test 수행
  - *Device: DDR, GDDR, LPDDR, NAND Flash, MCP 外*
- SEC - DRAM Burn-In 장비 1st 벤더 공급 中
  NAND 고속 Burn-In 장비 독점 공급 中
- SKH – D5 DRAM Burn-In 장비 1st 벤더 공급 中
  NAND 고속 Burn-In 장비 독점 공급 中
- A.I / 데이터센터 메모리 수요 및 투자 증가에 따른 노후 장비 교체 · 지속적 장비 공급 진행중

Logic Burn-In Tester & Boards

비메모리 검사장비



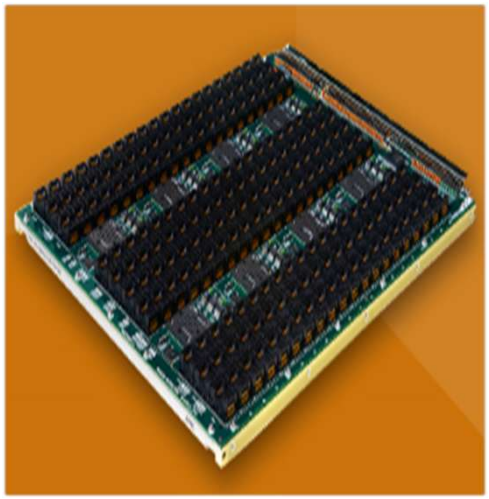
Logic Burn-In Tester

· Endurance Test를 제공하는 고성능 장비
  - *Device: DDI, SoC, Automotive, CIS 外*

· 중화권 비메모리 OSAT업체에 공급 中

· SEC向 Logic Burn-In Tester 공급 中
  - *중장기 국산화 Potential*

반도체 검사보드



Memory Burn-In Board

· 고객 Needs에 따라 다양한 설계 및 테스트 제공
  - *Device: DDR, LPDDR, GDDR, NAND Flash, Logic 外*

· SEC/SKH/해외 OSAT업체 등 다양한 고객사 확보

Memory Tester

Domestic

SAMSUNG

SK hynix

Overseas

China

YMTC, GigaDevice, Powertech Technology Inc., SPIL, JHICC 晋华, 沛顿科技 Payton Technology

Taiwan

Powertech Technology Inc., ChipMOS, FATC, TAC, MXIC Macronix International Co., Ltd., SPIL, Powerchip, WALTON

Brazil

HT MICRON semicondutores

Non-Memory Tester

Domestic

SAMSUNG

Overseas

INTEGRATED SERVICE TECHNOLOGY
MAtek
winbond
GIGA FORCE
苏试宜特 CHINASTI TESTING SERVICE
华虹宏力 HHGRACE
ASE GROUP
SUNWAY COMMUNICATION
聚跃检测 Juyue Inspection Technology

Boards

Domestic

SAMSUNG
SK hynix

Overseas

HITECH
MXIC MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD.
ChipMOS
CanSemi
winbond
ememory
Nexchip
GigaDevice

III Business Performance

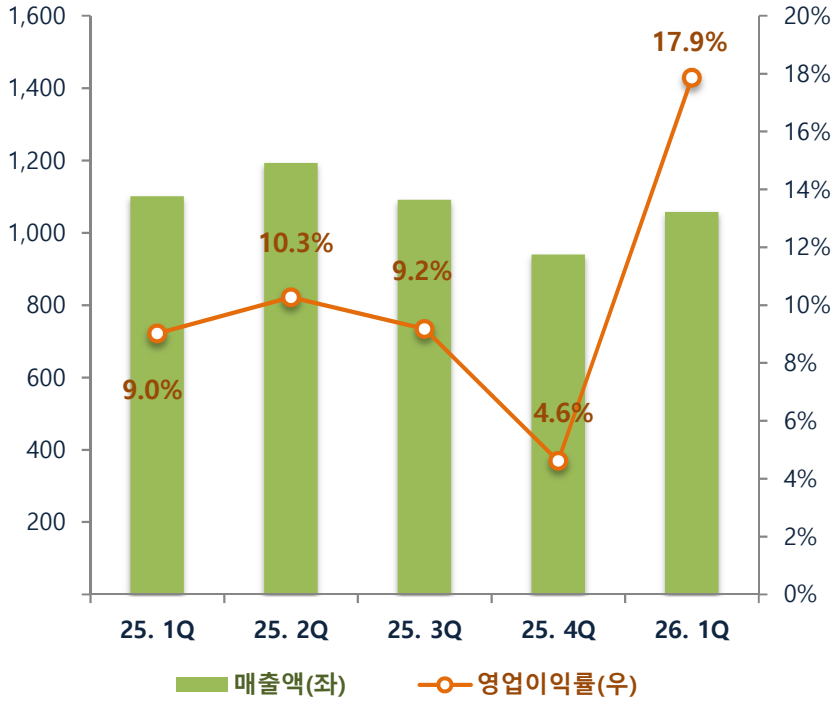
1. 분기별 실적
2. 연도별 실적
3. 수 주 잔 고

메모리 시장 구조적 성장에 따른 실적 상승 초입

· 글로벌 A.I / 추론 경쟁 심화에 따른 서버 투자 확대 및 메모리 장기 사이클 도래

▷ 1Q 매출액 : 1,057억 → DI (476억) – DDR5 Pkg Tester 수요 증가세 지속, 3분기 연속 성장
DF (544억) – HBM4 Wafer Tester 3월 납품 개시, 대규모 출하 초입

▷ 1Q 영업익 : 189억 → HBM4 장비 등 고수익성 제품군 매출 증가하며 영업이익률 18% 기록

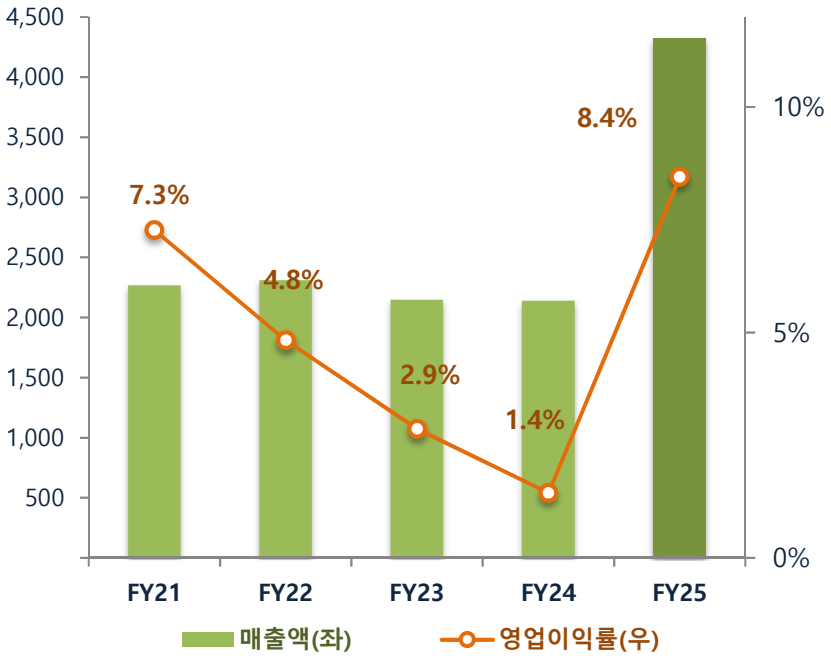


(단위: 억원)

	25.1Q	25.2Q	25.3Q	25.4Q	26.1Q
매 출 액	**1,100**	**1,193**	**1,091**	**939**	**1,057**
반도체 장비	1,020	1,155	1,036	849	1,046
전 자 부 품	31	31	26	25	29
2 차 전 지	40	38	17	84	16
기 타	54	38	47	51	37
연 결 조 정	-46	-69	-35	-70	-71
영 업 이 익	**99**	**123**	**100**	**43**	**189**

HBM 장비업체로 거듭나며 달라진 체급

- ‘21-’23, 삼성전자 向 신규 DDR5 Pkg Tester 선제적 투자 수혜
- ‘24, 하이닉스 DRAM 투자 재개하며 DF 실적 개선
- ‘25, 하이닉스 向 HBM3E Wafer Tester 공급 시작하며 실적 퀀텀점프
- ‘26, 하이닉스 HBM4 Wafer Tester / 삼성전자 컨벤셔널 메모리 투자 확대 기대



(단위: 억원)

	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
매 출 액	**2,266**	**2,310**	**2,145**	**2,140**	**4,323**
반도체 장비	2,105	2,044	1,730	1,720	4,061
전 자 부 품	118	149	126	134	113
2 차 전 지	62	102	272	149	179
기 타	239	216	207	247	191
연 결 조 정	-259	-200	-189	-110	-221
영 업 이 익	**165**	**112**	**61**	**31**	**365**

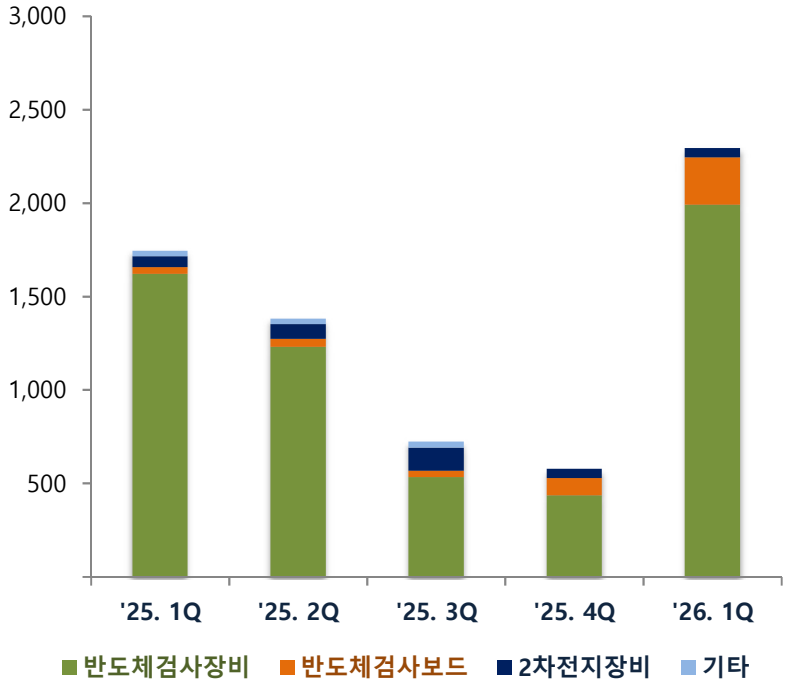
’26 더 커지는 HBM · 컨벤셔널 메모리 투자

· [DI] 삼성전자 컨벤셔널 메모리 전반 투자 확대 기대

▷ DRAM/NAND Pkg Tester 및 Burn-In Board YoY 투자규모 대폭 확대 예상

· [DF] SK하이닉스 신규 HBM4 검사장비 대규모 공급 개시

▷ HBM4 Wafer Tester*(B/I, Core)* 약 2천억 규모 수주 · 공급 진행중



(단위: 억원)

부 문	25.1Q	25.2Q	25.3Q	25.4Q	26.1Q
반도체검사장비	1,621	1,231	534	436	1,990
반도체검사보드	35	42	34	92	254
2차전지장비	60	79	122	49	58
기 타	28	29	34	-	-
합 계	**1,744**	**1,381**	**724**	**578**	**2,303**

INSIGHT DI



서울시 강남구 논현로703 | 02-546-5501 | www.di.co.kr